



# 平成 18 年 3 月期 中間決算短信（連結）

平成 17 年 10 月 28 日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社  
コード番号 2760

上場取引所 東京（市場第二部）  
本社所在都道府県 神奈川県

（URL <http://www.teldevice.co.jp>）

代表者 役職名 取締役社長 氏名 砂川 俊昭  
問合せ先責任者 役職名 財務部長 氏名 浅野 升徳 TEL (045)474 - 7000

決算取締役会開催日 平成 17 年 10 月 28 日

親会社等の名称 東京エレクトロン株式会社（コード番号：8035）

親会社等における当社の議決権所有比率 69.6%

米国会計基準採用の有無 無

## 1. 17 年 9 月中間期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日）

### (1) 連結経営成績 (百万円未満切捨)

	売上高	営業利益	経常利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
17 年 9 月中間期	42,622	1,438	1,218
16 年 9 月中間期			
17 年 3 月期			

	中間(当期)純利益	1 株当たり中間(当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当たり中間(当期)純利益
	百万円 %	円 銭	円 銭
17 年 9 月中間期	716	7,790 37	
16 年 9 月中間期			
17 年 3 月期			

(注) 当社は、平成 17 年 3 月期までは中間連結財務諸表及び連結財務諸表を作成しておりませんので、平成 16 年 9 月中間期及び平成 17 年 3 月期の連結実績は記載しておりません。

持分法投資損益 17 年 9 月中間期 百万円 16 年 9 月中間期 百万円 17 年 3 月期 百万円  
期中平均株式数(連結) 17 年 9 月中間期 92,000 株 16 年 9 月中間期 株 17 年 3 月期 株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

### (2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17 年 9 月中間期	39,311	14,614	37.2	158,854 29
16 年 9 月中間期				
17 年 3 月期				

(注) 期末発行済株式数(連結) 17 年 9 月中間期 92,000 株 16 年 9 月中間期 株 17 年 3 月期 株

### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17 年 9 月中間期	511	136	193	1,110
16 年 9 月中間期				
17 年 3 月期				

### (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 1 社 持分法適用非連結子会社数 社 持分法適用関連会社数 社

### (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1 社 (除外) 社 持分法(新規) 社 (除外) 社

## 2. 18 年 3 月期の連結業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	86,000	2,870	1,670

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 18,152 円 17 銭

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提条件その他に関する事項につきましては、添付資料の 10 ページをご参照ください。

## 企業集団の状況

当社を中心とする企業集団は、当社、親会社及び子会社 2 社で構成されております。

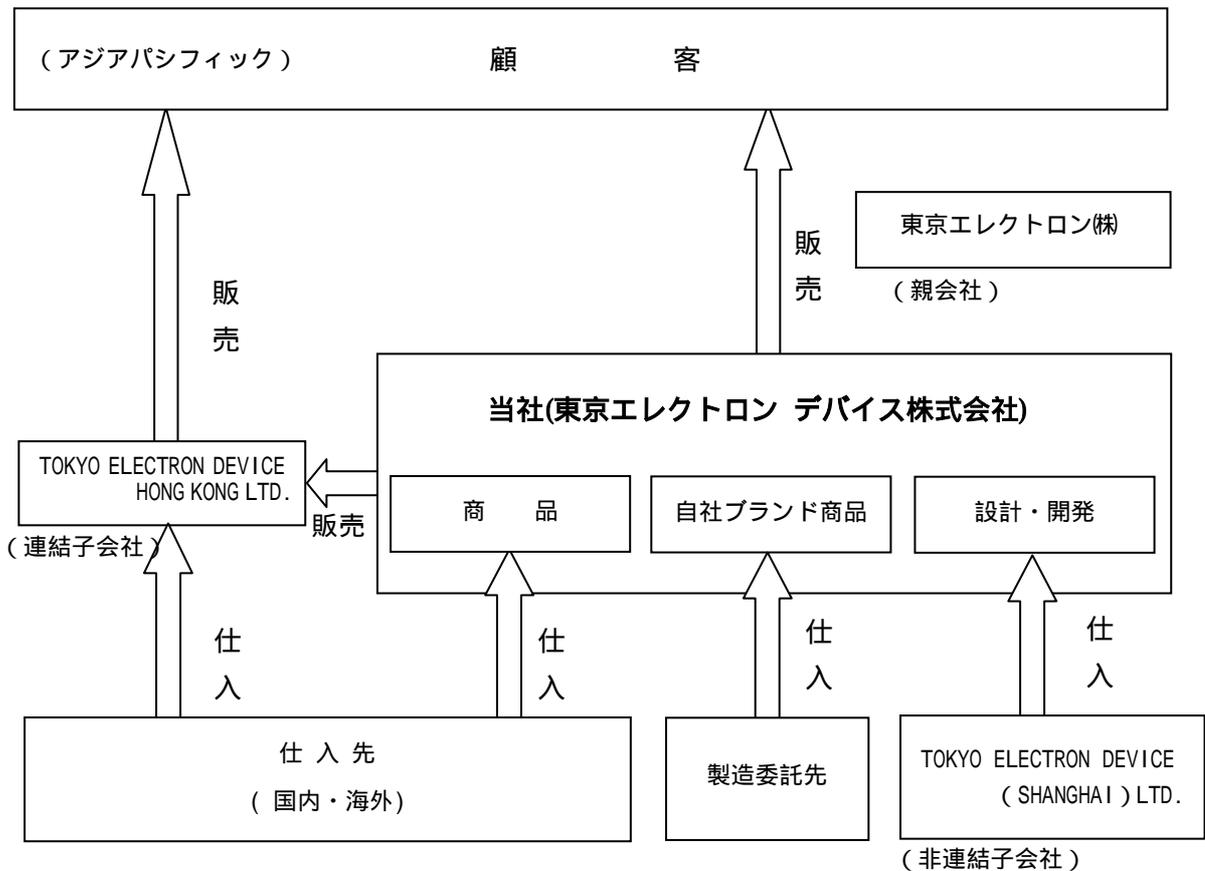
当社グループ(当社及び当社の子会社)は、集積回路を中心とした半導体製品、ボード製品、ソフトウェア、一般電子部品等、国内外のエレクトロニクス商品及び自社ブランド商品を主として大手電子機器メーカーに販売しております。

当社の連結子会社である TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. は、アジアパシフィックに生産拠点を展開している日系顧客に対し、エレクトロニクス商品の販売を行っており、また、当社の非連結子会社である TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. は、当社が委託した半導体等の回路設計・開発及びソフトウェアの設計・開発を行っております。

当社の親会社である東京エレクトロン株式会社は、半導体製造装置及び FPD (フラット・パネル・ディスプレイ) 製造装置、コンピュータ・ネットワーク等の産業用エレクトロニクス製品の販売を主な事業としております。

### <事業の系統図>

事業の系統図を示すと次のとおりであります。



(注) TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. につきましては、当中間連結会計期間より新たに連結子会社となりました。

# 経営方針

## 1. 経営の基本方針

当社グループは、技術力向上に努め、高付加価値ビジネスを志向し、安定した利益成長を図り、エレクトロニクス社会の発展へ貢献することを経営の基本方針としております。この基本方針のもと、株主、顧客及び従業員の満足度向上に取り組んで参ります。

## 2. 利益配分に関する基本方針

当社の配当政策は、株主重視を経営の最重要事項の一つと位置づけ、業績連動型・収益対応型配当の継続実施を基本方針としております。

内部留保金につきましては、自社ブランド商品の開発強化及びIT（情報技術）投資の実施等業容拡大のために有効活用するとともに、キャッシュ・フロー重視の経営に注力し利益成長を実現することを通じ、株主各位のご支援にお応えして参る所存であります。

## 3. 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

投資単位の引下げは、株式の流動性の向上及び投資家層の拡大に有効な施策であると認識しております。

投資家の皆様にとってより投資しやすい環境を整えるため、平成15年11月及び平成16年9月にそれぞれ1株につき2株の割合で株式の分割を実施いたしました。

今後につきましては、株価の動向、株式の流動性及び株主構成等を総合的に勘案し、必要に応じて適宜検討して参る所存であります。

## 4. 会社の対処すべき課題

当社グループが参画しておりますエレクトロニクス業界は、デジタルネットワーク化の進展を背景としたユビキタス社会の到来により、今後、更なる成長が期待されております。当社の顧客である電子機器メーカー及び仕入先である半導体メーカーは、常に技術革新による新たな商品の開発及び新たなビジネスモデルの創出を模索しており、また、その事業もグローバルに展開されております。このような状況におきまして半導体商社は、より一層の技術力向上とスピードが必要とされており、従来の物流、在庫管理、金融機能といった商社機能のみならず、半導体商社に対して求められる役割や機能が広がってきております。

このような環境のもと、当社グループは、自社ブランド「inrevium（インレビウム）」商品の開発やカスタムICを中心とする設計受託業務といった開発ビジネスに注力し、カスタムIC、アナログICなどの高付加価値商品の技術サポートを引き続き徹底して、顧客並びに仕入先から信頼される「No.1 技術商社」を目指して参ります。また、アジアパシフィックに生産拠点を展開している顧客に対応すべく、香港に現地法人を設立し、本年4月より営業を開始いたしました。今後につきましても、顧客に密着した営業体制の構築に努めて参ります。さらに、市場の変化に迅速に対応するためマーケティングの強化を図り、常に顧客ニーズに沿った商品開拓を行い、安定した利益成長の実現を目指して参る所存であります。

## 5. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

### (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、株主各位に対し一層の経営の透明性を高めるため、公正な経営を実現することを最優先に考えております。

今後も、更に経営の公正さと透明性を高めるために積極的かつ迅速な情報開示に努めて参ります。

### (コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

#### (1) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

会社の機関の内容、内部統制及びリスク管理体制

取締役会は、迅速な経営判断ができるよう現在、取締役7名の少人数で構成され、うち2名が社外取締役となり、公正な経営の実現、客観的な立場からの意思決定を行うことにより、取締役会の機能を高めております。

また、平成15年7月から、取締役会の内部委員会として、取締役社長を除くメンバーで構成される報酬委員会(3名)及び指名委員会(4名)を設置いたしました。報酬委員会においては代表取締役の報酬の決定を、指名委員会においては取締役候補者の選定及び取締役社長候補者の選定を行っております。

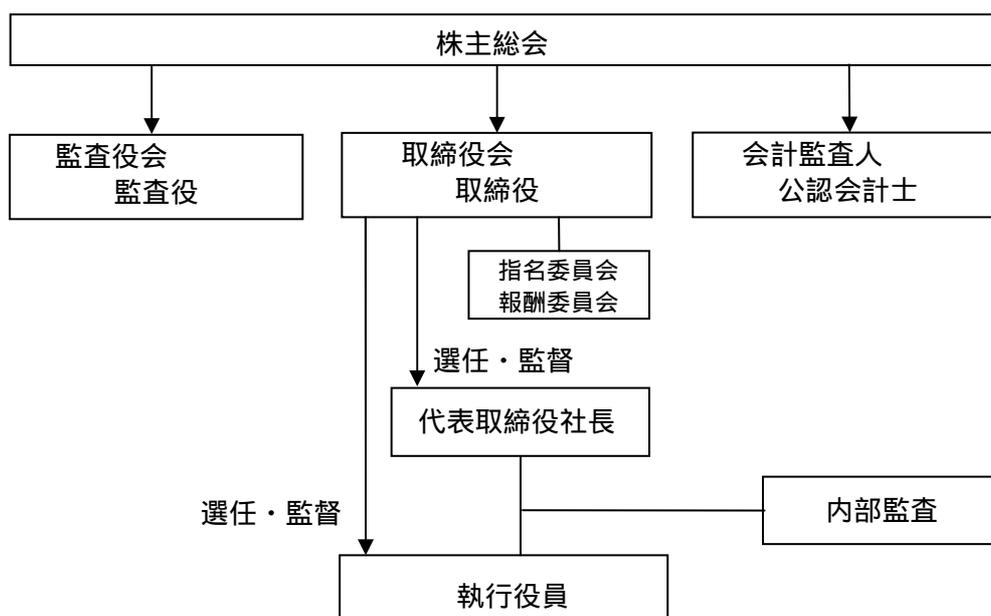
当社は、平成11年6月に執行役員制度を導入し、監督と執行の分離を明確にし、外部環境の変化に迅速な対応ができる体制を構築しております。

執行役員は現在9名であり、各部門に執行役員を責任者として配置し、権限委譲を行っております。執行役員を含めた経営会議を原則として月2回開催し、各部門から現状報告や提案がなされ、業務執行に関する具体的な対策等を決定しております。

当社は、監査役制度を採用しており、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。常勤監査役2名は取締役会以外にも、経営会議等の重要な会議に全て出席し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制になっております。

内部統制及びリスク管理体制につきましては、取締役会が選任した執行役員が業務の執行を行い、取締役会がその執行を監督するとともに、社長直轄の内部監査室が随時、必要な監査を実施し、報告を行うシステムを構築しております。同時に監査役会は内部統制システムの整備、運用状況を監査し、改善指摘を行う体制をとっております。また、法令や社会的規範の遵守意識の向上を図るため、コンプライアンス規程を制定し、具体的な行動の指針となる倫理行動基準を定めるとともに、社内通報制度を導入しております。顧問弁護士からは、コンプライアンスの観点から適宜アドバイスをいただいております。

以上を模式図に表すと次のとおりであります。



#### 会計監査の状況

業務を執行した公認会計士は以下の3名であります。

公認会計士 杉浦 文彦氏（公認会計士桜友共同事務所 代表構成員）

公認会計士 石井 和人氏（公認会計士桜友共同事務所 代表構成員）

公認会計士 鈴木 智喜氏（公認会計士桜友共同事務所 構成員）

監査業務に係る補助者は、公認会計士桜友共同事務所に所属する公認会計士4名であります。また、意見表明に関する審査については、公認会計士桜友共同事務所に常置されている審査委員会（証券取引法に基づく監査の業務執行者のみにより、委員長以下8名で構成される。）において、当社有価証券報告書の監査証明業務に従事していない委員により実施しているとの報告を受けております。

なお、監査役とは監査報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報、意見の交換を行っており、相互の連携を高めております。

#### (2) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的关系または取引関係その他の利害関係の概要

社外取締役2名は、親会社である東京エレクトロン株式会社の取締役であり、また、社外監査役（非常勤）2名は、親会社である東京エレクトロン株式会社の常勤監査役及び執行役員であります。当社と社外取締役及び社外監査役個人との間に特別な利害関係はありません。

#### (3) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

平成17年3月に内部統制及びリスク管理体制強化の取組みの一環として、法令や社会的規範の遵守意識の向上を図るため、コンプライアンス規程を制定し、具体的な行動の指針となる倫理行動基準を定めるとともに、社内通報制度を導入いたしました。

## 6. 親会社等に関する事項

### (1) 親会社等の商号等

(平成17年9月30日現在)

親会社等	属性	親会社等の議決権所有割合(%)	親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所等
東京エレクトロン株式会社	親会社	69.6	株式会社東京証券取引所 市場第一部

### (2) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

当社は親会社である東京エレクトロン株式会社を中心とする企業グループにおける電子部品部門を担っておりますが、事業上の依存関係はありません。経営体制の強化のため、親会社の役員等(5名)が当社役員を兼任しておりますが、出向者の受入れはありません。今後とも協力関係を継続しながら当社独自の経営を行って参ります。

## 経営成績及び財政状態

### 1. 当中間連結会計期間の概況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高止まりなど一部に不安要素はあるものの、企業収益の改善を背景にして設備投資は増加し、これまで低調であった個人消費にも持ち直しの動きが見られるなど、景気は踊り場から脱却して緩やかな回復基調となりました。

当社グループの参画いたしておりますエレクトロニクス業界におきましては、設備投資や個人所得の増加を背景に企業向け、個人向けともにパソコンの需要は堅調でありましたが、携帯電話につきましては、第三代機への移行は進展するものの携帯電話市場全体では盛り上がり欠ける状況で推移しました。また、薄型テレビ（PDP・液晶）の需要は旺盛でありましたが、デジタル家電分野全体では昨年秋からの在庫調整はほぼ終了しているものの回復感に乏しい状況で推移し、製品単価の下落が急速に進むなど、半導体電子部品市況は本格的な回復には至らない状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループはカスタム IC や専用 IC など、高度な技術サポートを要する高付加価値商品の販売に注力するとともに、顧客である電子機器メーカーの製品企画段階から参画し、製品開発に最適な半導体電子部品の提案、販売のみならず、設計受託業務、技術サポートと顧客の製品開発にかかる一貫したサービスの提供、マーケティングの強化に努めました。また、自社ブランド商品「inrevium（インレビウム）」のマーケティングを推進するなど、開発ビジネスにつきましてもより一層の強化に取り組んで参りました。さらに本年4月には、香港現地法人の営業を開始するなど顧客により密着した販売体制の構築を推進いたしました。

この結果、当中間連結会計期間の売上高は426億2千2百万円、経常利益は12億1千8百万円、中間純利益は7億1千6百万円となりました。

当中間連結会計期間の売上高の品目別の状況は次のとおりであります。

（単位：百万円）

	第21期 (平成17年9月中間期)		
	第1四半期	第2四半期	当中間期
半導体製品	16,810	20,766	37,577
ボード製品	710	1,181	1,891
ソフトウェア	656	831	1,488
一般電子部品	731	933	1,665
合計	18,909	23,712	42,622

**【半導体製品】**

産業機器分野における医療機器や FA 関連装置向けが堅調であったものの、携帯電話端末向け専用 IC 及びメモリー IC が低調となり、また、デジタル家電分野向け商品の急速な回復には至らず、当中間連結会計期間の売上高は、375 億 7 千 7 百万円となりました。

**【ボード製品】**

PC マザーボードや VME ボードなど FA 関連装置向けや通信機器向け音声処理ボードの拡販に努めた結果、当中間連結会計期間の売上高は、18 億 9 千 1 百万円となりました。

**【ソフトウェア】**

POS 端末を中心にした組み込みシステム機器向けなどに各種 OS、ツールの拡販に努めた結果、企業収益の改善を背景に IT 投資が増加したこともあり、当中間連結会計期間の売上高は 14 億 8 千 8 百万円となりました。

**【一般電子部品】**

スイッチング電源、液晶ディスプレイ、パネル PC などを中心に拡販に努め、デジタルビデオカメラ用液晶モニターの売上が堅調であったことから、当中間連結会計期間の売上高は、16 億 6 千 5 百万円となりました。

## 2. キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に比べ1億8千3百万円増加し、11億1千万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。なお、当中間連結会計期間より中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、前年同期との比較分析は行っておりません。

### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は5億1千1百万円となりました。これは主に、売上債権やたな卸資産の増加及び法人税等の支払いによる資金減少要因があった一方、税金等調整前中間純利益の計上及び仕入債務の増加等の資金増加要因がこれを上回ったためです。

### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、1億3千6百万円となりました。これは主に、本社空調工事費用等の支出によるものです。

### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、1億9千3百万円となりました。これは、短期借入金が増加した一方、配当金を支払ったことによるものです。

	第21期中
	平成17年9月
自己資本比率	37.2%
時価ベースの自己資本比率	61.1%
債務償還年数	7.9年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	11.4

自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

- 1 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
- 2 債務償還年数の中間期における計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため、2倍しております。

### 3. 通期の見通し

今後の見通しにつきましては、個人消費にも持ち直しの動きが見られることなどから、景気は引き続き回復傾向を持続するものと予想されます。

当社グループの参画いたしておりますエレクトロニクス業界におきましては、デジタル家電分野の在庫調整もほぼ終了し、緩やかながらも回復基調を辿るものと見込まれます。

こうした状況のもと、最近の業績動向等を踏まえ、前回公表（平成 17 年 7 月 28 日）の通期の業績予想を以下のとおり修正いたします。

#### (1)【連結】平成 18 年 3 月期通期業績予想数値の修正

(単位：百万円、%)

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想 (A) (平成 17 年 7 月 28 日発表)	85,000	2,870	1,670
今回修正予想 (B)	86,000	2,870	1,670
増減額 (B - A)	1,000	-	-
増減率	1.2	-	-
前期実績 (平成 17 年 3 月期)	-	-	-

(注) 前期 (平成 17 年 3 月期) につきましては、連結実績がありませんので記載しておりません。

#### (2)【個別】平成 18 年 3 月期通期業績予想数値の修正

(単位：百万円、%)

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想 (A) (平成 17 年 7 月 28 日発表)	83,500	2,830	1,640
今回修正予想 (B)	85,000	2,860	1,660
増減額 (B - A)	1,500	30	20
増減率	1.8	1.1	1.2
前期実績 (平成 17 年 3 月期)	88,079	2,820	1,916

#### (3) 利益配分に関する見通し

中間配分につきましては、1 株につき 3,000 円とさせていただきます。また、期末配分につきましては 1 株につき 3,000 円、通期では 6,000 円を予定しております。

#### 4. 事業等のリスク

##### (1) 業績の変動要因について

当社グループは、集積回路を中心とした半導体製品等、国内外のエレクトロニクス商品及び自社ブランド商品の販売を主な事業としていることから、当社グループの業績は、得意先である電子・電気・通信機器業界の半導体需要並びに設備投資動向等の影響を受ける可能性があります。当社グループでは、半導体の中でも付加価値が高く、価格変動が比較的少ない商品の取り扱いを増やすこと等によって、これらの影響を回避する方策を採っておりますが、半導体電子部品の市況が悪化すると当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。

##### (2) 為替変動の影響について

当社グループは、エレクトロニクス商品の輸出入取引を行っており、また、一部の国内顧客との間において外貨建取引を行っております。取引発生時と決済時の為替変動リスクに関しては、為替予約によってリスク回避に努めております。また、為替変動による仕入価格の変動に関しては、仕入価格の動向を勘案して販売価格を改定する等の方策を採っておりますが、急激な為替変動は当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

##### (3) 仕入先の依存度について

当社グループの主要な仕入先は、富士通株式会社及びザイリンクス社であり、当中間連結会計期間における当社グループの総仕入実績に対する割合はそれぞれ 26.0%及び 20.2%となっております。各社とは取引基本契約を締結し、これまで取引関係は安定的に推移してきましたが、このような取引関係が継続困難となった場合や、主要仕入先の製品需要の動向によっては、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

## 中間連結財務諸表等

当中間連結会計期間は連結財務諸表の作成初年度であるため、以下に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書については、前中間連結会計期間との対比を行っておりません。

### 中間連結貸借対照表

区分	注記 番号	当中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)	
		金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)			
流動資産			
1 現金及び預金		1,110,509	
2 受取手形及び売掛金		22,699,259	
3 たな卸資産		12,457,967	
4 その他		705,475	
貸倒引当金		10,815	
流動資産合計		36,962,396	94.0
固定資産			
1 有形固定資産	1	743,639	
2 無形固定資産		201,111	
3 投資その他の資産		1,404,498	
固定資産合計		2,349,249	6.0
資産合計		39,311,645	100.0

		当中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)	
区分	注記 番号	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)			
流動負債			
1		買掛金	11,772,550
2		短期借入金	84,915
3		一年以内返済予定 長期借入金	5,000,000
4		賞与引当金	367,154
5		その他	1,569,456
		流動負債合計	18,794,075
固定負債			
1		長期借入金	3,000,000
2		退職給付引当金	2,621,941
3		役員退職慰労引当金	84,833
4		その他	196,200
		固定負債合計	5,902,974
		負債合計	24,697,050
(資本の部)			
		資本金	2,495,750
		資本剰余金	2,054,850
		利益剰余金	10,061,106
		為替換算調整勘定	2,888
		資本合計	14,614,595
		負債及び資本合計	39,311,645
			47.8
			15.0
			62.8
			6.4
			5.2
			25.6
			0.0
			37.2
			100.0

中間連結損益計算書

区分	注記 番号	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日)		百分比 (%)
		金額(千円)		
売上高			42,622,355	100.0
売上原価			37,042,855	86.9
売上総利益			5,579,499	13.1
販売費及び一般管理費				
1 給料手当		1,569,663		
2 賞与引当金繰入額		367,144		
3 退職給付引当金繰入額		298,588		
4 その他		1,905,727	4,141,122	9.7
営業利益			1,438,377	3.4
営業外収益				
1 受取利息		226		
2 セミナー開催収入		3,438		
3 受取保険配当金		11,782		
4 受取保険差益		4,491		
5 その他		1,728	21,667	0.1
営業外費用				
1 支払利息		44,977		
2 債権譲渡損		48,392		
3 為替差損		144,137		
4 その他		3,740	241,248	0.6
経常利益			1,218,796	2.9
特別利益				
1 貸倒引当金戻入益		1,940	1,940	0.0
特別損失				
1 固定資産除却損		1,293	1,293	0.0
税金等調整前中間純利益			1,219,442	2.9
法人税、住民税及び 事業税			502,729	1.2
中間純利益			716,713	1.7

中間連結剰余金計算書

		当中間連結会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日)	
区分	注記 番号	金額(千円)	
(資本剰余金の部)			
資本剰余金期首残高			
資本剰余金増加高			
1 連結初年度による増加額		2,054,850	2,054,850
資本剰余金中間期末残高			2,054,850
(利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高			
利益剰余金増加高			
1 連結初年度による増加額		9,642,392	
2 中間純利益		716,713	10,359,106
利益剰余金減少高			
1 配当金		276,000	
2 役員賞与		22,000	298,000
利益剰余金中間期末残高			10,061,106

中間連結キャッシュ・フロー計算書

		当中間連結会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日)
区分	注記 番号	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1	税金等調整前中間純利益	1,219,442
2	減価償却費	125,934
3	貸倒引当金の増減額	1,940
4	賞与引当金の増減額	64,447
5	退職給付引当金の増減額	42,857
6	役員退職慰労引当金の増減額	10,008
7	受取利息及び受取配当金	226
8	支払利息	44,977
9	為替差損益	713
10	売上債権の増減額	1,446,731
11	たな卸資産の増減額	1,794,081
12	仕入債務の増減額	3,141,575
13	未収消費税等の増減額	106,658
14	その他	335,497
	小計	942,084
15	利息及び配当金の受取額	226
16	利息の支払額	45,034
17	法人税等の支払額	385,688
営業活動によるキャッシュ・フロー		
		511,588
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1	有形固定資産の取得による支出	143,728
2	無形固定資産の取得による支出	11,522
3	その他	18,532
投資活動によるキャッシュ・フロー		
		136,717
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1	短期借入金の純増減額	82,140
2	配当金の支払額	276,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		
		193,860
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,029
現金及び現金同等物の増減額		183,040
現金及び現金同等物の期首残高		927,469
現金及び現金同等物の中間期末残高		1,110,509

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日)
1 連結の範囲に関する事項	<p>(1)連結子会社の数 1社 連結子会社の名称 TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD.の重要性が増加したため、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しております。</p> <p>(2)非連結子会社の名称 TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. (連結の範囲から除いた理由) 非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p>
2 持分法の適用に関する事項	<p>(1)持分法を適用した非連結子会社又は関連会社数 なし</p> <p>(2)持分法を適用しない非連結子会社(TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD.)は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等から見て、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。</p>
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項	<p>連結子会社の中間決算日は中間連結財務諸表提出会社と同一であります。</p>
4 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法	<p>デリバティブ 時価法によっております。</p> <p>たな卸資産 先入先出法による原価法を採用しております。</p> <p>有形固定資産 当社は定率法によっております。ただし、建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。在外連結子会社は定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 2～45年 工具、器具及び備品 2～15年</p> <p>無形固定資産 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 また、市場販売目的のソフトウェアについては見込販売期間(3年以内)に基づく定額法によっております。</p> <p>長期前払費用 定額法によっております。</p>

項目	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日)
<p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>(4) リース取引の処理方法</p> <p>(5) ヘッジ会計の方法</p> <p>(6) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項</p>	<p>貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。在外連結子会社は、主に個別の債権について回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上しております。</p> <p>退職給付引当金 当社は従業員の退職給付に備えるため、当中間連結会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（4年）による定額法により按分した額を費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（4年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>役員退職慰労引当金 当社は役員の退職金支給に備えるため、内規に基づく当中間期末退職金要支給額を計上しております。</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：デリバティブ取引（先物為替予約） ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引</p> <p>ヘッジ方針 為替予約取引については、為替相場の変動によるリスク回避を目的とし、通常の外貨建営業取引に係る契約等を踏まえ、必要な範囲内で為替予約取引を利用し、投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段との関係が直接的であり、為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性評価は省略しております。</p> <p>消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p>
<p>5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p>	<p>中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する短期的な投資からなっております。</p>

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

当中間連結会計期間末 (平成17年9月30日)	
1 有形固定資産の減価償却累計額	619,794千円
2 売掛債権流動化の目的で、「ローンパーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号)に基づいて、参加者へ売却したものとして会計処理した売掛金の金額は525,433千円であります。	

(中間連結損益計算書関係)

当中間連結会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日)
当中間連結会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当中間連結会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日)
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(平成17年9月30日現在) 「現金及び現金同等物」の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている「現金及び預金」の金額は一致しております。

(リース取引関係)

半期報告書の開示をE D I N E Tにより行うため、記載を省略しております。

(有価証券関係)

当中間連結会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日)
開示の対象となる有価証券はありません。

(デリバティブ取引関係)

半期報告書の開示をE D I N E Tにより行うため、記載を省略しております。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当中間連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)

当社及び連結子会社は、単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当中間連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載は省略しております。

【海外売上高】

当中間連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(1株当たり情報)

当中間連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	
1株当たり純資産額 158,854円29銭	
1株当たり中間純利益 7,790円37銭	
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当中間連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)
中間純利益(千円)	716,713
普通株主に帰属しない金額(千円)	
(うち利益処分による役員賞与金)	( )
普通株式に係る中間純利益(千円)	716,713
期中平均株式数(株)	92,000
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	平成16年6月18日定時株主総会決議ストックオプション普通株式300株。平成17年6月21日定時株主総会決議ストックオプション普通株式350株。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 仕入、受注及び販売の状況

当中間連結会計期間における「仕入、受注及び販売の状況」を品目別に示すと、次のとおりであります。

### (1) 仕入実績

品目	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日)	
	仕入高(千円)	増減率(%)
半導体製品	34,883,448	
ボード製品	1,229,176	
ソフトウェア	1,217,971	
一般電子部品	1,520,487	
合計	38,851,083	

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注実績

品目	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日)			
	受注高 (千円)	増減率 (%)	受注残高 (千円)	増減率 (%)
半導体製品	38,554,062		6,423,319	
ボード製品	1,992,114		495,876	
ソフトウェア	1,517,493		86,699	
一般電子部品	1,449,953		184,261	
合計	43,513,624		7,190,157	

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 金額は販売価格によっております。

(3) 販売実績

品目	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日)	
	販売高(千円)	増減率(%)
半導体製品	37,577,133	
ボード製品	1,891,822	
ソフトウェア	1,488,171	
一般電子部品	1,665,227	
合計	42,622,355	

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	当中間連結会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日)	
	金額(千円)	割合(%)
松下電器産業株式会社	7,521,260	17.6

## (ご参考)

### (1) 連結貸借対照表(四半期比較)

区分	当第1四半期 (平成17年6月30日)		当第2四半期 (平成17年9月30日)		比較増減
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	1,192,850		1,110,509		
2 受取手形及び売掛金	19,299,435		22,699,259		
3 たな卸資産	13,033,930		12,457,967		
4 その他	761,541		705,475		
貸倒引当金	9,624		10,815		
流動資産合計	34,278,133	93.5	36,962,396	94.0	2,684,262
固定資産					
1 有形固定資産	754,761		743,639		
2 無形固定資産	217,807		201,111		
3 投資その他の資産	1,406,657		1,404,498		
固定資産合計	2,379,225	6.5	2,349,249	6.0	29,976
資産合計	36,657,359	100.0	39,311,645	100.0	2,654,286

区分	当第1四半期 (平成17年6月30日)		当第2四半期 (平成17年9月30日)		比較増減
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
1 買掛金	10,260,441		11,772,550		
2 短期借入金	11,063		84,915		
3 一年以内返済予定 長期借入金	5,000,000		5,000,000		
4 賞与引当金	212,213		367,154		
5 その他	1,233,283		1,569,456		
<b>流動負債合計</b>	<b>16,717,001</b>	<b>45.6</b>	<b>18,794,075</b>	<b>47.8</b>	<b>2,077,074</b>
<b>固定負債</b>					
1 長期借入金	3,000,000		3,000,000		
2 退職給付引当金	2,613,515		2,621,941		
3 役員退職慰労引当金	79,052		84,833		
4 その他	193,700		196,200		
<b>固定負債合計</b>	<b>5,886,267</b>	<b>16.1</b>	<b>5,902,974</b>	<b>15.0</b>	<b>16,707</b>
<b>負債合計</b>	<b>22,603,269</b>	<b>61.7</b>	<b>24,697,050</b>	<b>62.8</b>	<b>2,093,781</b>
<b>(資本の部)</b>					
資本金	2,495,750	6.8	2,495,750	6.4	
資本剰余金	2,054,850	5.6	2,054,850	5.2	
利益剰余金	9,501,411	25.9	10,061,106	25.6	559,694
為替換算調整勘定	2,079	0.0	2,888	0.0	809
<b>資本合計</b>	<b>14,054,090</b>	<b>38.3</b>	<b>14,614,595</b>	<b>37.2</b>	<b>560,504</b>
<b>負債資本合計</b>	<b>36,657,359</b>	<b>100.0</b>	<b>39,311,645</b>	<b>100.0</b>	<b>2,654,286</b>

## (2) 連結損益計算書(四半期比較)

区分	当第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)		当第2四半期 (自平成17年7月1日 至平成17年9月30日)		比較増減	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	比率 (%)
売上高	18,909,891	100.0	23,712,464	100.0	4,802,573	25.4
売上原価	16,474,597	87.1	20,568,258	86.7	4,093,661	24.8
売上総利益	2,435,293	12.9	3,144,206	13.3	708,912	29.1
販売費及び一般管理費	2,083,027	11.0	2,058,095	8.7	24,931	1.2
営業利益	352,266	1.9	1,086,110	4.6	733,844	208.3
営業外収益	7,023	0.0	14,643	0.0		
営業外費用	92,457	0.5	148,790	0.6		
経常利益	266,832	1.4	951,964	4.0	685,132	256.8
特別利益	3,131	0.0	1,191	0.0		
特別損失	1,025	0.0	267	0.0		
税引前四半期純利益	268,937	1.4	950,505	4.0	681,568	253.4
法人税、住民税及び 事業税	111,918	0.6	390,811	1.6		
四半期純利益	157,019	0.8	559,694	2.4	402,675	256.4

## (3) 連結キャッシュ・フロー計算書(四半期比較)

	当第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)	当第2四半期 (自平成17年7月1日 至平成17年9月30日)	比較増減
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー			
1 税引前四半期純利益	268,937	950,505	
2 減価償却費	62,377	63,557	
3 貸倒引当金の増減額	3,131	1,191	
4 賞与引当金の増減額	219,322	154,875	
5 退職給付引当金の増減額	51,284	8,426	
6 役員退職慰労引当金の増減額	15,789	5,781	
7 受取利息及び受取配当金		226	
8 支払利息	21,957	23,020	
9 為替差損益	389	324	
10 売上債権の増減額	1,918,469	3,365,200	
11 たな卸資産の増減額	2,384,190	590,109	
12 仕入債務の増減額	1,674,838	1,466,737	
13 未収消費税等の増減額	175,774	69,116	
14 その他	412,139	76,641	
小計	1,036,106	94,022	1,130,129
15 利息及び配当金の受取額		226	
16 利息の支払額	39	44,994	
17 法人税等の支払額	378,991	6,697	
営業活動による キャッシュ・フロー	657,076	145,487	802,564
投資活動による キャッシュ・フロー			
1 有形固定資産の取得による支出	132,035	11,693	
2 無形固定資産の取得による支出	11,379	143	
3 その他	14,187	4,345	
投資活動による キャッシュ・フロー	129,226	7,490	121,735

	当第1四半期 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日)	当第2四半期 (自 平成17年7月 1日 至 平成17年9月30日)	比較増減
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
財務活動による キャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純増減額	11,063	71,077	
2 配当金の支払額	276,000		
財務活動による キャッシュ・フロー	264,937	71,077	336,014
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,468	439	2,908
現金及び現金同等物の増減額	265,381	82,341	347,722
現金及び現金同等物の期首残高	927,469	1,192,850	265,381
現金及び現金同等物の 四半期末(中間期末)残高	1,192,850	1,110,509	82,341

## (4) 連結受注実績推移(四半期比較)

品目	当第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)	当第2四半期 (自平成17年7月1日 至平成17年9月30日)	比較増減
	受注高(千円)	受注高(千円)	金額(千円)
半導体製品	18,512,739	20,041,323	1,528,583
ボード製品	838,055	1,154,058	316,003
ソフトウェア	808,571	708,921	99,649
一般電子部品	1,042,613	407,340	635,273
合計	21,201,980	22,311,643	1,109,663